



## 产品技术参数规格

### ZH 8106 导电性胶粘剂

#### 1 产品简介:

昭华科技 ZH 8106 导电胶可粘接蓝宝石、硅、银、铜、陶瓷等同种或异种材料，适用于数码管以及数码点阵等半导体平面发光元器件封装工艺以及邦定工艺，适合手动背胶与自动机台，具有低模量，极少的溢流，附着力强等特点。

#### 2 产品特点:

- (1) 单组分，使用工艺简单，操作方便；
- (2) 纯度高，杂质离子含量低；
- (3) 导电率高，导电性能稳定；
- (4) 粘结强度高，与多种基材都具有优良的粘接性能；
- (5) 储存稳定性好，受环境因素影响小等。

Typical Uncured Properties 参数名称		ZH 8106	Test Description 测试方法描述	Test Method 测试方法
Filler type 填充料		Ag		
Viscosity @ 25°C 粘度		18000-20000 cps	ZH-087	ATM-0018
Thixotropic index 触变指数		> 5	ZH-032	ATM-0089
Work life @ 25°C 工作时间		72 hours	ZH-053	ATM-0087
Storage life @ -40°C 储存时间		>6 months		ATM-0068
Weight loss on cure 热失重		1.8%	ZH-044	ATM-0073
Recommended cure condition 建议烘烤条件		Ramp to @ 150°C/90min		
Ionics	Chloride Cl <sup>-</sup>	< 0.1 ppm	ZH-032	ATM-0007
	Sodium Na <sup>+</sup>	< 5 ppm		
	Potassium K <sup>+</sup>	< 0.2 ppm		
Thermal Conductivity 导热系数		3.2 W/mK	ZH-018	ATM-0116
Volume Resistivity 电阻率		$1.1 \times 10^{-4}$ ohm-cm	ZH-035	ATM-0082
Die shear strength (N/m <sup>2</sup> ) (Post cure) 推力测试		$\geq 7.6 \times 10^7$	ZH-042	ATM-0052



## 包装规格:

35g/支 (10cc)、100g/瓶、200g/瓶、500g/瓶，特殊包装规格需另商议。


## 储存条件:

冷冻状态下-15℃至-40℃存储，室温下解冻 30-60 分钟后均匀搅拌后才可使用，针筒包装免搅拌，未用完的胶水需严格密封后再冷藏。

## 重要声明:

本产品样本中提供的技术参数仅供参考，以上数据信息是在环境温度 25℃、相对湿度 70%环境下对产品测试所得到的典型数据，以便广大客户使用时提供可能的建议。

它们会随不同的工况条件，如设备类型、材质、工艺条件等改变。

我公司商标为 ，如非我公司标签产品，请勿参照此说明书，因此引起的任何后果，我司将不承担任何责任。

使用产品之前，请仔细阅读材料安全资料，产品及产品使用说明。使用者应先确定产品是否符合所需之用途，需承担使用这些产品有关之风险和责任。卖方不向使用者或其他有关人士承担因使用（包括不当使用）卖方的产品而引起的伤害或任何直接、间接、意外或后续性损失的责任。